

第 60 回レーザー加工学会論文集

Proceedings of the 60th Laser Materials Processing Conference

目 次

特別講演

- | | |
|--|----|
| ポーラス金属の製造と応用開発 大阪大学産業科学研究所：中嶋 英雄 | 1 |
| 国際会議にみる先端レーザー精密加工技術の現状とレーザー産業の課題 (有)パラダイムレーザーリサーチ：鷺尾 邦彦 | 9 |
| 電子デバイス実装の歴史と今後の展開 (株)河野 ME 研究所：河野 英一 | 13 |

ダイシング関連技術

- | | |
|---|----|
| サファイア基板のUVレーザースクライビング加工 (株)レーザーソリューションズ：長友 正平, 李 日会, 栗山 規由 | 24 |
| Low-k/Cu 配線半導体デバイスのダイシング技術 (株)ディスコ：荒井 一尚 | 29 |
| LIPAA プロセスの開発とダイシングへの応用 理化学研究所：杉岡 幸次, 花田 修賢, 緑川 克美, 丸文(株)：山岡 裕 | 32 |

ダイシングその他

- | | |
|---|----|
| Advanced Laser Micromachining Methods for Large Area and High Throughput Applications エキシテック(株) | 37 |
| シングルモードファイバーレーザーを用いた精密微細加工 JDS Uniphase：Andrew Leuzinger, Mark Keirstead, 丸文(株)：武田 晋 | 39 |
| フェムト秒レーザーによる表面加工技術と実用化への課題 大阪大学(財)レーザー技術総合研究所：藤田 雅之, 京都大学化学研究所：橋田 昌樹, 宮崎大学地域共同研究センター：甲藤 正人, 大阪大学接合科学研究所：塚本 雅裕 | 43 |